

证券代码：300656

证券简称：民德电子

## 深圳市民德电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-07

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他： <u>线上/电话会议</u>
参与单位名称	前海开源基金、中欧基金、康禧资本、泰康资产、中金资管、平安人保、中国人保、北京京管泰富基金、上海慈阳投资、上海冲积资管、深圳远望角投资、浙商证券、招商证券、东方财富证券、财通证券、华安证券
时间	2024年10月25日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：陈国兵 证券事务代表：杨佳睿
投资者关系活动主要内容介绍	<p>首先介绍了民德电子2024年前三季度财务情况，随后介绍了目前公司主要投资事项和重点业务的进展情况，最后对投资者关心的问题进行了解答。</p> <p><b>一、公司财务情况介绍</b></p> <p>2024年1-9月，公司实现营业收入25,983.66万元，较上年同期减少2,337.99万元，同比减少8.26%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,019.80万元，较上年同期减少2,727.19万元，同比减少159.73%；经营活动产生的现金流量净额4,373.58万元，较上年同期减少1,604.94万元，同比减少26.85%。</p> <p>2024年1-9月，公司归属上市公司股东的净利润较上年同期减少的主要原因有：</p> <p>(1) 条码识别设备业务保持良好增长势头，收入和利润相比上年同期均实现两位数增长，其中海外市场销售收入大幅增长，为公司持续贡献现金流；(2) 联营企业广芯微电子与芯微泰克均处于产能爬坡阶段，单位固定成本较高，且今年开始计提固定资产折旧费用，因此利润较上年同期减少明显，但收入和产销量在快速增长；同时，半导体市场有所回暖，联营企业晶睿电子外延片销量较上年同期大幅增长，外延片单片销售价格逐月提升，但尚未恢复到上年同期水平，收入同比增长明显，但毛利率同比下</p>

降，以及计提员工股权激励费用等，导致净利润较上年同期下降，由此导致公司按权益法核算的长期股权投资收益较上年同期明显减少；（3）全资子公司泰博迅睿电子元器件客户结构及代理产品调整，且受电芯价格波动及下游市场需求低迷影响，泰博迅睿收入和净利润较上年同期减少；（4）受（6英寸）晶圆代工产能迁移影响，功率半导体设计公司广微集成销售收入和净利润较上年同期减少，近期已在主要客户端完成变更晶圆代工厂后的产品验证测试，并逐步放量。

## 二、公司主要投资事项及重点业务进展情况介绍

### （一）投资事项进展

公司目前正在进行的投资并购事项为控股收购晶圆代工厂广芯微电子：公司于今年年初启动收购丽水绿色基金和丽水高质量基金持有的广芯微电子部分股权，其中与丽水绿色基金 9.8361% 股权转让协议，以及丽水高质量基金 0.9197% 股权转让协议已签署完成，以招拍挂的形式参与收购丽水绿色基金 4.9180% 股权转让事项已签订收购意向书，上述交易预计将于今年年底前完成，届时，公司将持有广芯微电子 50.1% 的股权，广芯微电子将成为公司控股子公司，纳入公司合并财务报表范围。晶圆代工作为公司打造的 smart IDM 生态圈中最核心的环节，广芯微电子并入上市公司业务体系后，将进一步提升公司核心竞争力，增强对核心战略资产的掌控力度，公司也将成为国内少数控股晶圆代工厂，并在产业链核心环节均实现自主可控的功率半导体企业。

### （二）功率半导体近期业务进展

1、晶圆代工厂广芯微电子自去年底开始量产，今年一直处于产能爬坡阶段，各方面工作正常有序推进。目前广芯微电子共有 350 余名员工，已量产的产品包括两大类，一类是 MOS 场效应二极管，一类是 VDMOS。MOS 场效应二极管为控股子公司广微集成设计的产品，已量产 45V-150V 全系列百余款型号，产品良率已经达到其在之前代工厂良率的历史最高水平；VDMOS 为公司参股投资的公司丽隼半导体设计的产品，目前已量产 200V-2,000V 全系列多种型号，产品良率高于业界平均水平；上述两款产品已经在下游客户端逐步开始得到验证和销售。广芯微电子预计今年底实现 6 英寸硅基晶圆产出 2 万/月，预计 2025 年底实现产出 7 万/月，同时将于明年启动 IGBT 和重金属 FRD 等产品的开发。

2、设计公司广微集成在广芯微电子生产的 MFER 产品，近期已在主要客户端完成变更晶圆代工厂后的产品验证测试，并逐步放量，随着广芯微电子产能的提升，广

微集成的销量有望得到快速提升。晶圆原材料公司晶睿电子的产销量和产品单价今年以来均在不断提升，背道代工厂芯微泰克已获得多家业内知名企业验证，产能快速增长，晶睿电子和芯微泰克目前都在开展市场化融资工作。随着各家产能和市场的不断增长，公司打造的 smart IDM 生态圈产业链协同效益体现也越来越明显。

### **（三）AiDC 业务进展**

公司于去年底将条码识别业务战略升级为 AiDC（Artificial Intelligence & Data Capture，人工智能&数据采集）事业部，基于 Ai+CIS 的机器视觉平台，拓展了更宽的赛道。今年前三季度，AiDC 业务保持良好增长势头，收入和利润相比上年同期均实现两位数增长，其中海外销售增长超 40%。目前，公司将所有条码产品都升级为采用 Ai 处理器方案的新品，主要对标日本的基恩士、美国的康耐视等工业类机器视觉产品，赛道更广阔，且毛利更高。今年，公司在 IVD（体外诊断设备）行业的系列扫码设备推广顺利，已覆盖数多家品牌客户；同时，公司针对 3C 制造产线开发的工业读码器系列产品，目前已在客户产线进行测试。公司 AiDC 业务在今年依然会保持稳健增长，并持续为公司带来正向现金流。

**总体来看，公司在 AiDC 和功率半导体两大重点业务板块的经营持续向好。**公司 AiDC 业务近年来保持稳健增长，今年前三季度营收和利润均实现两位数以上增加，毛利率也有所提升；同时，因为公司近几年在功率半导体领域投入较大，且属于生产方面的重资产投入，在前期产能较小的情况下，折旧摊销及运营成本较大，公司利润方面承受一定压力，后续随着各家产能的不断提升，以及市场回暖，功率半导体业务也有望步入快速增长期。

### **三、问答交流**

#### **1、公司对广芯微电子实现 50.1%控股后，对剩余股权的规划？**

答：今年初，公司启动对广芯微电子的控股收购，预计今年年底完成全部交易，届时公司将持有广芯微电子 50.1%的股权，实现对广芯微电子的控股，广芯微电子将纳入上市公司业务体系。对于广芯微电子剩余股权，后续我们将根据广芯微电子的发展情况再和各方沟通协商，目前暂未有明确规划。

#### **2、除已控股的广微集成和即将控股的广芯微电子之外，公司对投资的其他功率半导体公司的股权规划？**

答：公司致力于打造功率半导体 smart IDM 生态圈，即通过资本参股或控股的方

式，打通功率半导体全产业链，实现供应链的自主可控。因此，公司对外开展投资并购围绕公司产业布局和战略规划进行，既有控股型收购，也有参股型投资；各家企业彼此既能在战略上相互协同，守望相助，又各自保持独立运营，充分接受市场竞争。

目前，公司完成了在功率半导体设计、晶圆原材料、晶圆代工、超薄片背道代工等关键环节的布局。除广微集成和广芯微电子之外，对于晶圆原材料公司晶睿电子和超薄片背道代工厂芯微泰克，公司将作为重要股东保持一定影响力，后续不会增加资金投入；投资方面，公司将持续关注特色功率半导体设计领域，对技术能力优秀的设计公司（如丽隽半导体和熙芯微电子）进行投资，并利用产业链进行赋能，帮助其做强做大，以不断壮大 smart IDM 生态圈。

### 3、公司碳化硅业务的进展情况？

答：公司在碳化硅器件领域是基于供应链自主可控的战略进行布局，碳化硅产业链覆盖外延片制造、晶圆制造、超薄片背道加工、芯片设计等关键环节。目前，晶睿电子的碳化硅外延片生产设备已完成安装调试并开始生产，产品已通过了几家客户的验证，后续将根据客户需求陆续开始出货；晶圆代工厂广芯微电子和超薄片背道代工厂配备了生产碳化硅产品所需的设备；芯片设计公司广微集成、丽隽半导体等 smart IDM 生态圈内企业，均有碳化硅器件产品量产经验，技术储备丰富。

公司坚持以硅基器件为基本盘，来拓展碳化硅器件，相较于只做碳化硅产品的厂商，从固定资产折旧摊销角度，公司碳化硅器件产品成本方面也将有更大的优势。现阶段，广芯微电子和芯微泰克均在产能爬坡阶段，且广芯微电子生产碳化硅产品和目前已量产的产品部分工序是通用的，两家公司现阶段核心任务是快速提升现有产品产能，后续将根据产能爬坡进度及市场情况，适时启动产线的调试和碳化硅产品的生产。

附件清单（如有）	无
日期	2024-10-25